■ 电子元器件用银表面电极浆料

◆ 特征：

* 银灰色膏状流体，主要由银粉、玻璃粉和有机粘合剂组成，不含铅、隔、铬等有害物质，符合 Rohs 环保要求。
* 烧结后与瓷体结合紧密，附着力高，银层致密，导电率高。
* 应用于电子元器件的银表面电极制造。

◆ 产品在电子元器件中应用示意图及产品图片





◆ 物理性能：

型 号	固含量（%）	粘 度*（Pa·S）	细度（第二刻线/90%）	适用性
MOV-1368	73.0±2.0	30～50	≤25μm	氧化锌压敏电阻器
MOV-1160	67.2±1.5	30～50	≤25μm	氧化锌压敏电阻器
MOV-1366A	71.8±1.0	35～55	≤25μm	氧化锌压敏电阻器
MOV-1370E	74.5±1.5	30～50	≤25μm	氧化锌压敏电阻器
MOV-1375	77.5±1.5	30～60	≤25μm	氧化锌压敏电阻器
MOV-1160A	67.2±1.5	30～50	≤25μm	NTC 热敏电阻器
SGT-9160	64.5±1.5	26～68	≤25μm	瓷介电容器
SGT-8152	56.5±1.5	30～42	≤25μm	蜂鸣片
SGT-8075	78.5±1.5	30～42	≤25μm	滤波器、换能片
MOV-0060M	64.0±1.0	15~40	≤25μm	NTC 热敏电阻器

(注*：粘度检测条件为 Brookfield HBDV-Ⅱ+,CP52, 10.0rpm，25±0.5℃)

◆ 产品特点：

*该浆料所用关键材料银金属粉体为我司自制，可以接受客户定制不同银含量浆料。

◆ 推荐工艺：

* 搅　拌：使用前慢速搅拌均匀。
* 丝　印：200～300 目不锈钢丝网或尼龙丝网。
* 烧　结：推荐峰值温度及保温时间如下：

型号	烧结温度范围（℃）	保温时间（min）
MOV-1368	550±50	10～20
MOV-1160	550±50	10～20
MOV-1366A	550±50	10～20
MOV-1370E	550±50	10～20
MOV-1375	550±50	10～20
MOV-1160A	550±50	10～20
SGT-9160	815±10	8～15
SGT-8152	800±20	8～15
SGT-8075	800±20	8～15
MOV-0060M	500~650	10~20

◆ 产品使用注意事项

* 清　　洗： 建议使用无水乙醇清洗。
* 储存条件： 建议在温度 18～25℃、湿度≤75%环境密封储存，避免置于阳光直射或含有腐蚀性气体环境中。
* 有 效 期： 建议在符合上述储存条件下 6 个月内使用。
* 包装规范： 采用 PE 塑料瓶，500g/瓶或 1000g/瓶或 2000g/瓶。

■ 修订履历

版本	日期	修订内容	修订人
A0	2025-10-23	新版格式要求重新整理整版内容	郭精华
A1	2026-8-29	新增 MOV-0060M 浆料性能参数，调整版本格式	叶自艺

注：上述所提供之内容为产品规格说明。在产品未变更时，风华保有修改此内容不另行通知之所有权利，任何产品变更将会以 PCN 通知客户。